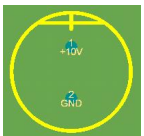


PCB	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
焊接工艺要求	交流伺服	ISED-F30FXS1E 焊接要求	V1	1	2023-4-10
<p>1. 参照“ISED-F30FXS1E_V1 元件序号（元件值）PDF”文件；</p> <p>2. 在板子的背面，有四个没有元件的长圆孔，要开钢网，做加锡处理，锡的高度不小于 0.2mm ；</p> <p>3. U32(AX58100)中心有一个焊盘，钢网需要开孔 进行焊接；</p> <p>4. 在 D5、D14、J13 的背面，有 11 个长圆孔，镀锡高度 不少于 0.2mm ；</p> <p>5. 有焊接高度要求的元件</p> <p>D5、D14 的管脚高出线路板 8mm 整，并要横平竖直；</p> <p>Q2 的管脚高出线路板 9.4mm 整，并要横平竖直；</p> <p>R157、R189、R190 圆体底部高出线路板 2~3mm；</p> <p>6. 焊接 U1 时要保证 U1 的<u>上平面</u> 平行于线路板，U1 的管脚本身有自然的卡点，卡点紧贴线路板；</p> <p>7. 电容 C2 为直插件，焊接前需成型，电容躺平在线路板上、并紧贴线路板焊接，不允许翘起 ；</p> <p>8. 红色框内的元件不焊接；</p> <p>9. 打叉的元件，不焊接；</p> <p>10.  图形中的“+”号，表示是电容的正极，焊接时要注意；</p> <p>11. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；</p> <p>12. 线路板的背面 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品；</p> <p>13. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准</p>					
编制		审核		批准	
日期		日期		日期	